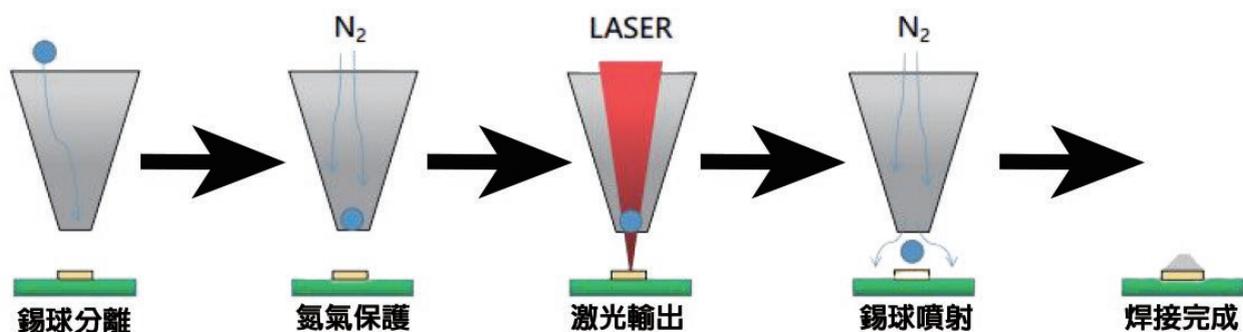




## 特點

- 焊接過程無助焊劑產生，無錫爆，焊接後無需清潔。
- 溶錫噴射至焊點，避免焊接過程中產生的熱壓力。
- 加熱區域集中，及短焊接時間，特別適合引腳細間距小等高精密微點焊接場合。
- 採用錫球自動供料方式，確保錫量的一致性。
- 搭配氮氣產生器，全程氮氣保護。



激光焊接示意圖

## 技術規格

型號			
激光焊接	視覺	定位方式	光學自動定位
		定位相機	500W像素
	行程	X:300mm Y:400mm Z:100mm	
	編程方式	軟件編程	
	重覆精度	X/Y/Z(mm)	±0.02
	錫球	Φ 200- Φ 1300	
	功率	100/150/300(可選)	
	波長	1064nm	
	尺寸	L850*W1100*H1900(mm)	
	重量	380kg	